

Title (en)

METHOD AND APPARATUS FOR CHEMICAL VAPOR DEPOSITION.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR CHEMISCHEN DAMPFNIEDERSCHLAG.

Title (fr)

PROCEDE ET APPAREIL DE DEPOT DE VAPEURS CHIMIQUES.

Publication

EP 0162111 A1 19851127 (EN)

Application

EP 85900326 A 19841120

Priority

US 55448983 A 19831123

Abstract (en)

[origin: WO8502417A1] Method and an apparatus for the deposition of material on a substrate (7) through the method of chemical vapor deposition without degrading the substrate by thermal stress. The substrates are supported by a carrier (6). Heat is supplied to the carrier from the side opposite the substrate by one energy source (5) and to the side with the substrates by a second focused, or nearly focused, radiant energy source (12) located outside the process chamber (2, 4). This complimentary heating configuration permits thin, flat substrates to be heated quickly and efficiently to high temperature without inducing undesirable thermal stress.

Abstract (fr)

Procédé et appareil de dépôt de matière sur un substrat (7) en utilisant un processus de dépôt de vapeurs chimiques sans dégradation du substrat par des contraintes thermiques. Les substrats sont supportés par un support (6). L'apport de chaleur au support du côté opposé aux substrats s'effectue par une source d'énergie (5) et il s'effectue sur le côté avec les substrats à l'aide d'une seconde source d'énergie radiante focalisée ou presque focalisée (12) située à l'extérieur de la chambre de traitement (2, 4). Cette configuration de chauffage complémentaire permet de chauffer rapidement et efficacement des substrats minces et plats en les portant à une température élevée sans induire des contraintes thermiques indésirables.

IPC 1-7

C23C 16/00

IPC 8 full level

C23C 16/46 (2006.01); **C23C 16/48** (2006.01)

CPC (source: EP)

C23C 16/46 (2013.01); **C23C 16/481** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

WO 8502417 A1 19850606; EP 0162111 A1 19851127; EP 0162111 A4 19860915; JP S60116778 A 19850624

DOCDB simple family (application)

US 8401928 W 19841120; EP 85900326 A 19841120; JP 24254384 A 19841119